

株主通信

2024年12月期決算のご報告
(2024年1月1日～2024年12月31日)

株式会社 **日本マイクロニクス**

証券コード：6871

株主・投資家の皆さまへ

To Our Shareholders

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

市場について

第54期（2024年1月1日から2024年12月31日）連結会計年度の世界経済は、インフレの沈静化を背景に緩やかな回復基調を辿ったものの、ウクライナや中東での紛争長期化による地政学的リスクの高まりに加え、中国国内需要の低迷や米中対立の激化などにより、先行き不透明な状況が続きました。

当社グループが軸足を置く半導体市場においては、生成AIの市場成長を背景に、データセンターへの高い投資が続いたことで、特に高性能GPU（画像処理半導体）やHBM（高性能メモリ）の需要が急拡大しました。しかし、汎用DRAM市場は、メモリ半導体メーカーの減産効果により在庫調整が進み、一定の価格上昇が見られたものの、パソコンやスマートフォンなどの市況が振るわず、回復は非常に緩やかになると予想されています。車載用や産業機器向け半導体の回復も遅れております。その結果、生成AI関連が市場牽引の主役となりました。

業績について

このような事業環境のなか、当社グループは中期経営計画「FV26」で掲げた重点施策の着実な遂行に全力を傾注しました。高いシェアを誇るメモリ向けプロープカードについては、HBM

向けを中心に基軸製品の安定供給に努め、拡大する市場ニーズの取り込みを図りました。ノンメモリ分野については、2023年8月に投入したロジック向けプロープカード「MEMS-V」の市場浸透に注力し、TE事業に関してはリリースした新製品の顧客評価と拡販活動および、各プロダクトの強化に向けた研究開発を推進しました。半導体市場の将来的な成長を見据えて建設中であった青森工場の新棟は2024年12月に竣工し、現在は2025年12月期第3四半期の本格稼働に向けて生産ラインの構築を進めているところです。

こうした取り組みの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高55,643百万円（前年同期比45.3%増）、営業利益12,572百万円（前年同期比136.7%増）、経常利益12,250百万円（前年同期比115.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益8,811百万円（前年同期比113.5%増）となりました。メモリ半導体市場の成長が今後も継続する見通しであることから、2024年11月に「FV26」の投資計画ならびに目標指標の見直しを行いました。引き続きグループの総力を挙げて「FV26」の進捗に注力し、売上高800億円、営業利益200億円の達成を確実なものとしてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 **長谷川 正義**

中期経営計画『FV26』の上方修正

当社グループは、2023年8月10日に、2024年12月期から2026年12月期までの3年間を対象とする中期経営計画『FV26』を公表し、その達成に向けて諸施策を実行してまいりました。最近の業績動向を踏まえ、改めて環境分析をおこなった結果、中長期的に市場はさらに成長するとの見通しから、2024年11月11日に中期経営計画FV26の経営指標の修正をおこないました。

修正の要点

修正の背景

半導体市場全体の回復傾向と、メモリ市場のさらなる拡大を見据えて需要増加に備えるべく、積極的な成長戦略に向けた追加投資をおこないます。なお、2023年8月10日に公表した重点施策に変更はございません。

経営指標

経営指標 最終年度2026年12月期	見直し前	見直し後
売上高	650億円	800億円
営業利益額	150億円	200億円
営業利益率	23%	25%
ROE	20%	23%

※前提条件(見直し前)：
プローブカード市場が年平均成長率(2024-2026)7%で成長した場合、3カ年の平均想定為替レート1ドル=130円
前提条件(見直し後)：
プローブカード市場が年平均成長率(2024-2026)20%で成長した場合、3カ年の平均想定為替レート1ドル=147円

投資計画

投資計画 2023年~2026年(4年間)	見直し前	見直し後
設備投資額	300億円	480億円
研究開発費	200億円	220億円
総額	500億円	700億円

半導体の市場予測



プローブカード市場予測



設備投資



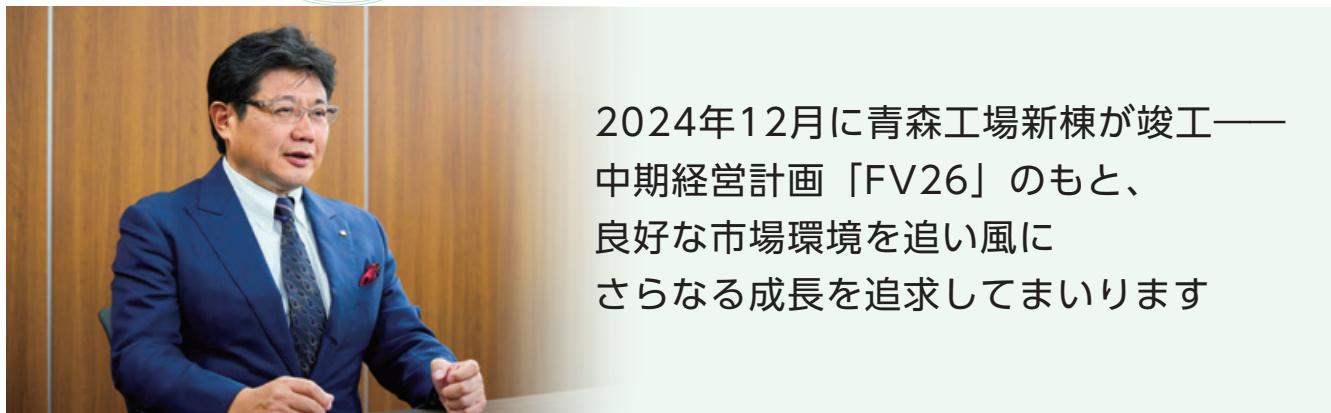
研究開発投資



青森工場新棟



メモリ向けプローブカード「U-Probe」



2024年12月に青森工場新棟が竣工——
中期経営計画「FV26」のもと、
良好な市場環境を追い風に
さらなる成長を追求してまいります

Q 第54期(2024年12月期)の事業環境とMJCの取り組みを総括してください。

A 当期の事業環境に関して特に注目されるのは、AIサーバー向け半導体デバイス市場が大きく伸びたことでしょう。生成AI用のハイエンドAIサーバーに使用されるHBM（高性能メモリ）に対する需要が急速に拡大し、新しいカテゴリーを形成する勢いを見せています。HBMの需要急伸を見越して十分な供給体制を構築できていたかどうか、それがプロブカードメーカー各社の明暗を分けたように感じています。当社グループはこれまで、HBMに対応する高付加価値製品の開発に注力すると同時に、機動的かつ安定的な生産体制の構築に注力してきました。こうした取り組みが、市場ニーズの確実な取り込みに繋がり、売上・利益の拡大に帰結したものと受け止めています。当社グループは半導体業界や資本市場において、DRAM向けに加え生成AI用のHBM向けプロブカードにおいてもリーディングサプライヤーとして認知されています。引き続き、設備投資と研究開発投資に経営リソースを重点配分し、市場でのプレゼンスをさらに高めたいと考えています。

Q 2024年12月に青森工場の新棟が竣工しました。稼働準備の進捗状況をご説明ください。

A 2024年11月に公表した中期経営計画「FV26」の見直しでは、最終年度である2026年12月期の売上高を650億円から800億円に上方修正しました。売上高800億円を達成するためのカギが青森工場の新棟です。現在、2025年第3四半期からの本格量産に向けプロセスの構築を進めており、お客様のニーズに迅速かつ確に対応する機動的な生産体制が確立されつつあります。当社は定期的に半導体市場予測の見直しを行うとともに、半導体メモリ大手顧客からのヒヤリングを通じて、計画の見直しなどを行っております。2024年11月の中期経営計画修正はこれら予測結果によるものです。ただ、半導体市場は変動が激しく、現在の状況が今後も長期にわたって続くかどうかは予測が難しい状況です。投資資金をなるべく早く回収できるよう、生産・販売戦略の最適化を図っていく方針です。

Q サステナビリティへの貢献について、どのように考えていますか。

A 脱炭素化を支える技術やシステムには必ず半導体を使用されています。半導体検査を手掛ける当社グループの社会的な使命は重く、地球環境に配慮したものづくりを徹底していくことが企業存続の前提条件だと考えています。また、当社グループは主力の青森工場をはじめ、国内外に多数の生産拠点を有しており、生産工程における環境負荷の低減に取り組むことはもとより、社会貢献活動や地元雇用を通じて地域社会の発展に寄与することも大切な役割だと考えています。今後も、ESG（環境・社会・ガバナンス）を重視した経営と事業を継続し、株主さま、お客さま、地域住民の皆さまなど、すべてのステークホルダーから信頼される企業グループをめざしてまいります。

Q 持続的成長を支える基盤づくりに関してご説明をお願いします。

A 当社グループは、DXと人的資本の充実を、経営基盤を強化するための最重要課題と位置づけています。DXについては、事務作業の電子化によって業務の効率化を図ると同時に、製造プロセスの自動化を通じて生産性の一層の向上に努めています。また、これまで社内に蓄積してきた技術資産や社員・スタッフの技能情報をデータベース化し、次の世代へ継承する取り組みもスタートしています。DXはデジタルツールの活用という限定的な施策ではなく、最新のデジタル技術を駆使して新たな価値を創造していく全社戦略です。引き続き、DX情報システム部を中核に、MJC ChatGPTなどの社内サービスも有効活用しつつDXの進展に力を注いでまいります。

Q 最後に第55期(2025年12月期)の経営方針を教えてください。

A 第55期は、当社グループがDRAMならびにHBMのNo.1サプライヤーとして、さらなる飛躍を果たすための重要な年度だと考えています。同時に、ノンメモリ市場の回復が期待されるため、ノンメモリ向けプロブカードを<第2の柱>とするため、拡販に積極的に取り組んでいきます。TE事業では、収益性の改善に寄与する新型テストや新型プローバーの顧客評価が順調に進行しています。当社グループの根幹であり競争優位の源泉であるR&Dについては、基礎研究から製品開発までを包摂する幅広い取り組みを通じて、産業と社会を変革する新技術・新製品の創出を図っていきます。株主さまへの利益還元に関しては従来通り、安定的かつ継続的な配当と、着実な利益成長による株主価値の最大化——その両面で日頃のご支援にお応えしていく考えです。また株主さまをはじめ、さまざまなステークホルダーの方々に当社グループの現況と将来ビジョンをより詳細に知っていただくため、ウェブサイトや各種制作物、決算説明会に加え、今後はSNSでの情報発信にも力を入れていく方針です。青森工場新棟が始動する2025年12月期は、MJCの歴史に画期を刻むワクワクする年度となるでしょう。当社グループのこれからのぜひご注目ください。

Topics

01

株式会社アドバンテストとの
戦略パートナーシップ契約を締結

ホームページで既にお知らせしているとおり、当社は2025年2月27日に株式会社アドバンテストと戦略的パートナーシップ契約を締結しました。半導体技術の進化に伴い、今後ますます半導体テストの高度化・複雑化が進むことが見込まれる中、顧客からは、これまで以上に高度で効率的なテストソリューションが求められています。当社は、アドバンテスト社とともに、それぞれの専門性を活かしながら、次世代半導体のテストにおける顧客の期待に応えるため、革新的な半導体テストソリューションの提供を目指すことに合意しました。このパートナーシップにより、次世代半導体テスト技術ソリューションの開発、テストプロセスおよびテストコストの最適化に取り組んでまいります。

Topics

02

工場見学会の開催と
海外カンファレンスへの参加

2024年10月、青森工場および青森松崎工場において、機関投資家・アナリスト向け工場見学会を実施しました。青森工場では、プロープカード事業説明、展示製品の見学、当時まだ建設中であった新棟の外観をご覧いただきました。青森松崎工場では、TE事業の基本的な事業内容や製品をご説明しました。

どちらの工場でも、多くのご質問をいただき、時間の許す限り意見交換をおこない、有意義な見学会となりました。参加者の皆さまには、アンケートにご協力いただき、当社の事業や製品についてよく理解できたとのフィードバックを多く得られました。

生成AI関連に注目が集まるなか、当社への投資家からの注目度は一層高まっています。11月には、シンガポールで開催された、アジア地域の投資家を集める証券会社主催のカンファレンスに招待され、長谷川社長が参加しました。多数の海外投資家との対話を通じて、当社を広くアピールする機会となりました。

今後も、各種イベントを通じて、当社事業をご理解いただくための活動を積極的に実施します。



Topics

03

SEMICON Japan 2024に出展しました

2024年12月11日～13日に東京ビッグサイトで「SEMICON Japan 2024」が開催されました。当社は日本で初めてSEMICONが開催された1977年から毎年出展しています。

今回のSEMICON Japanには約1,100社が出展、来場者数は3日間で10万人を超え、半導体業界への関心の強さと期待が感じられました。

当社ブースでは、「プロープカード」「テストソケット」の実機展示や「プロープ」のパネル展示、「カスタムテスタ」はデモンストレーションも交え、たくさんのお客さまにご覧いただき、当社製品をアピールしました。

他にも会場では、バスケットボールロボットや卓球ロボットなど、AIロボットとスポーツをテーマとした実演も注目を集めていました。

SEMICONは半導体産業の盛んな世界各地で開催されており、当社は台湾や中国、ヨーロッパのSEMICONにも出展しています。

当社は今後もSEMICONへの出展を通じて、半導体検査におけるリーディングカンパニーとして、業界の発展に貢献してまいります。



Topics

04

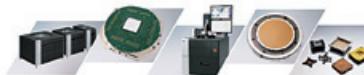
SNSによる当社イベントの
発信を開始しました

当社の公式LinkedInの投稿を開始いたしました。ホームページでは見えない、よりリアルな会社の雰囲気を感じていただけるように、海外現地法人を含めたMJCグループの社内外イベントや季節の挨拶などを、定期的に投稿する予定です。SNSを活用して、より多くの方に当社を知っていただけるよう努めてまいります。ご興味ございましたらぜひフォローをお願いいたします。

Support Through
Semiconductor Testing

MJC

MICRONICS JAPAN CO., LTD.
MJC YOUR Best Partner, MJC Anytime Anywhere



売上高

55,643 百万円

前年同期比 45.3%増



営業利益

12,572 百万円

前年同期比 136.7%増



親会社株主に帰属する
当期純利益

8,811 百万円

前年同期比 113.5%増



※各期の実績は、百万円以下切り捨てて表記しております。

業績予想 (2025年2月14日現在)

Earnings Forecast

	第55期 第2四半期累計予想
売上高	33,600 百万円
営業利益	7,500 百万円
親会社株主に帰属する中間純利益	5,400 百万円

株式事務についてのご案内

About Stocks

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
 連絡先 東京都府中市日鋼町1-1
 電話0120-232-711 (通話料無料)
 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株式会社 **日本マイクロニクス**
 〒180-8508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-6-8
<https://www.mjc.co.jp/>

